

2022.5.6 新产品发布

本公司接受了美国大型半导体厂商购买用于 先端半导体封装的“焊锡球植球系统”的订单

艾美柯技术株式会社（AIMECHATEC, Ltd.，总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄），接受了美国大型半导体厂商购买整条线焊锡球植球系统的订单，现发布如下。

如今，电脑已从桌面计算机进化到移动终端，已进入了AI时代，半导体封装所承担的任务也随之发生着剧烈的变化。以大容量，高速通讯，低耗能等的需求为背景，各家半导体厂商除了加强微纳制程技术的开发外，还努力推进着包括多芯片和三维晶片堆叠的高性能封装技术的开发。本公司提案的新型G系列设备，在植球技术上应用了我们通过平板显示量产设备培养过来的系统集成技术，因而受到了客户的高度评价，结果得到了本次订单。

需要高性能封装技术的先端半导体封装，对品质，良品率的要求也很高，因此能实现更高良品率的本公司产品会被广泛采用。我们期待该产品会为半导体相关事业的发展带来更多的贡献。

本公司愿意通过制程工艺上的不断创新，为了创造更舒适方便，更丰富多彩的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

咨询：艾美柯技术株式会社

营业部 TEL：0297-62-9119

https://www.ai-mech.com/wp_zh/